



Gowin RiscV_AE350_SOC 软件开发工具包

发布说明

RN1033-1.0, 2023-09-12

版权所有 © 2023 广东高云半导体科技股份有限公司

GOWIN高云、Gowin、GOWIN 以及高云均为广东高云半导体科技股份有限公司注册商标，本手册中提到的其他任何商标，其所有权利属其所有者所有。未经本公司书面许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

本档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止反言或其它方式授予任何知识产权许可。除高云半导体在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，高云半导体概不承担任何法律或非法律责任。高云半导体对高云半导体产品的销售和 / 或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。高云半导体对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，高云半导体保留修改文档中任何内容的权利，恕不另行通知。高云半导体不承诺对这些文档进行适时的更新。

版本信息

日期	版本	描述
2023/09/12	1.0	初始版本。

目录

目录	i
1 关于发布	1
2 功能和增强总述.....	2
3 平台支持	3
4 文档.....	4
5 技术支持	5

1 关于发布

本次发布 Gowin RiscV_AE350_SOC V1.0 软件开发工具包：

- 支持单片机软件编程
- 支持嵌入式 RTOS 软件编程，包括 FreeRTOS、uC/OS-III、RT-Thread Nano 和 Zephyr
- 支持 DSP 软件编程

RiscV_AE350_SOC V1.0 软件开发工具包请在高云半导体网站下载：

<http://www.gowinsemi.com.cn/prodshow.aspx>。

RiscV_AE350_SOC 软件与硬件参考设计已完成参数配置，请在 RDS 软件（已测试软件版本：V1.0），以及云源软件（已测试软件版本：V1.9.9 Beta-3）中使用。

2 功能和增强总述

功能	描述
FPGA 软件工具	已测试软件版本: Gowin_V1.9.9 Beta-3
MCU 软件工具	已测试软件版本: RiscV_AE350_SOC_RDS_V1.0_win
新功能支持	<ul style="list-style-type: none">● 支持单片机软件编程● 支持嵌入式 RTOS 软件编程, 包括 FreeRTOS、uC/OS-III、RT-Thread Nano 和 Zephyr● 支持 DSP 软件编程
增强项	-

3 平台支持

本次发布的 RiscV_AE350_SOC 软件开发工具包对应软件支持的平台有：

Windows	Windows 7/8/10/11 (64 bits)
Linux	Ubuntu 20.04 LTS

4 文档

本次 RiscV_AE350_SOC 发布文档如下表所示，PDF 文档可在高云网站下载或在线查看。

文档	
SUG1031, Gowin RiscV AE350 SOC 硬件设计用户手册	Online, PDF
SUG1029, Gowin RiscV AE350 SOC 软件编程用户手册	Online, PDF
SUG1030, Gowin RiscV AE350 SOC 快速开发用户手册	Online, PDF
SUG1032, Gowin RiscV AE350 SOC DSP 软件编程用户手册	Online, PDF
RN1033, Gowin RiscV AE350 SOC 软件开发工具包发布说明	Online, PDF

5 技术支持

高云半导体提供全方位技术支持，在使用过程中如有任何疑问或建议，可直接与公司联系：

网址：www.gowinsemi.com

E-mail：support@gowinsemi.com

Tel: +86 755 8262 0391

